

Grinding Technology Japan 2025 出展社一覧 (2024年12月5日現在)

ISBE GmbH / FDPW	株式会社コイズミツール	トランザーフィルター日本株式会社
株式会社アイゼン	株式会社ゴージャ	／日本ホートン株式会社
／株式会社リスモツール	株式会社古賀	DENGFENG WUDU ABRASIVES CO., LTD.
／シオンダイヤモンド工業株式会社	山水先端技術株式会社	株式会社ナーゲル・アオパレシジョン
株式会社旭商工社	三和クリエーション株式会社	／ELGAN Diamantwerkzeuge GmbH & Co. KG
旭ダイヤモンド工業株式会社	株式会社ジェイテクト	株式会社ナガセインテグレックス
株式会社アマダマシナリー	／株式会社ジェイテクトマシンシステム	株式会社ニートレックス
株式会社アライドマテリアル	／株式会社ジェイテクトグラインディングツール	日興キャステイ株式会社
有限会社アリュース	／三井精機工業株式会社	／関西特殊工作油株式会社
／ホーコス株式会社	株式会社シギヤ精機製作所	日清工業株式会社
／株式会社イウシタ	シグマ電子工業株式会社	日本ダイヤモンド株式会社
アルテックス株式会社	Shanxi Taiyue Abrasive Co.,Ltd.	日本ハードメタル株式会社
株式会社石川工具研磨製作所	CR GEMS Superabrasives Co., Ltd.	日本RIHON株式会社
和泉産業株式会社	XUCHANG GREAT ABRASIVE CO.,LTD.	二和ダイヤモンド株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社	株式会社潤滑通信社	浜井産業株式会社
入野機工株式会社	株式会社スギノマシン	Foshan Huagao Abrasive Co.,Ltd
宇宙経済新聞合同会社	住友重機械ファインテック株式会社	フォルマー・ジャパン株式会社
株式会社宇都宮製作所	株式会社スリーエフ技研	福田貿易株式会社
有限会社ウソノ研磨工業所	セイコーインスツル株式会社	二村機器株式会社
AFCジャパン株式会社	切削フォーラム21	プリンクマン・ポンプ・ジャパン株式会社
／ハイペリオン マテリアルズ アンド テクノロジーズ ジャパン	CemeCon 株式会社	プロソニック株式会社
株式会社エスアンドエフ	双龍産業株式会社	株式会社プリリ
／SAV GmbH	ダイナミックツール株式会社	株式会社ポイントナイン
NKワークス株式会社	大弥精機株式会社	株式会社マイスター
エリコンジャパン株式会社	株式会社太陽機	牧野フライス精機株式会社
株式会社オカスギ	ZHENGZHOU JIADING ABRASIVE MANUFACTURING CO., LTD	株式会社ミスズ
株式会社岡本工作機械製作所	Zhengzhou Xinli Wear-Resistant Material Co., Ltd.	有限会社三井刻印
株式会社片桐製作所	Zhengzhou ZZDM SUPERABRASIVES CO.,LTD	株式会社ものづくりレビュー
HENAN ABRASIVESTOCKS TECHNOLOGY CO., LTD	ZHENG ZHOU SILICA NEWMATERIALCO.,LTD	株式会社ヤマシタワークス
Henan SEPPE TECHNOLOGIES CO., LTD	ZHENGZHOU HEYDAY ABRASIVES CO., LTD	／日本スピードショア株式会社
HENAN KEMEI ABRASIVES CO.,LTD.	Zhengzhou Ruizuan Diamond Tool Co., Ltd	ユアサ商事株式会社
Henan Sanhui New Materials Co.,Ltd	Tyrolit Japan KK	／株式会社ツガミ
Henan Hold Diamond Technology Company	ZOLLER Japan 株式会社	／有限会社サンメンメンテナンス工機
Henan Yuxing Carbon Material Co., Ltd	株式会社東京精密	／株式会社ジェイ・シー・シー
Henan Ruiheng New Material Co., Ltd.	株式会社東京ダイヤモンド工具製作所	／東洋スクリーン工業株式会社
株式会社木村製作所	東昇商事株式会社	ユニマグテック株式会社
株式会社キラ・コーポレーション	東洋研磨材工業株式会社	菱高精機株式会社
株式会社きりしま	株式会社トーカロイ	Luoyang Sunrise Import & Export Trading Co., Ltd.
クール・テック株式会社	トーマイダイヤ株式会社	レッテンマイヤージャパン株式会社
株式会社グローバルダイヤモンド	株式会社トクビ製作所	(五十音順)

出展対象

- 研削盤 ● 研磨盤 ● 砥石 ● ツルレーン装置 ● 計測機器 ● 周辺機器 ● 研削工具
- 工具研削盤 ● 切削工具 ● 切削工具製造技術 ● 切削工具活用技術 ● 切削油 ● 切削油供給装置
- 切削油ろ過装置 ● 切削工具素材・材料 他

SiC,GaN 加工技術展 2025 出展社一覧 (2024年12月5日現在)

アイクリスタル株式会社	株式会社ジェイテックコーポレーション	ビュアオンジャパン株式会社
株式会社アライドマテリアル	SHANDONG JINMENG NEW MATERIAL CO., LTD.	／アンカーテクノ株式会社
インサイト株式会社	秀和工業株式会社	株式会社フォトニクラティス
株式会社荏原製作所	シンコー株式会社	不二越機械工業株式会社
応用物理学会 先進パワー半導体分科会	Zigong Fengrui abrasive Co.,Ltd.	株式会社フジインコーポレーテッド
株式会社岡本工作機械製作所	Semi Glory Electronics Materials Co., Ltd.	合同会社プリマテック
オグラ宝石精機工業株式会社	／LONGTECH PRECISION MACHINERY CO., LTD.	Mipox 株式会社
オックスフォード・インストゥルメンツ株式会社	つくばパワーエレクトロニクスコンステレーション	株式会社牧野フライス製作所
株式会社オプトサイエンス	(TPEC、産業技術総合研究所)	ムサシノ電子株式会社
Guangzhou Summit Crystal Semiconductor Co.	株式会社東京精密	／株式会社ニューメタルス エンドケミカルス コーポレーション
神津精機株式会社	株式会社東邦銅機製作所	株式会社安永
株式会社斉藤光学製作所	日本エクシード株式会社	LINSHU DONGSHENG ABRASIVE CO,LTD
株式会社サミットスーパーアブレーション	日本エンギス株式会社	レーザーテック株式会社
三菱工業株式会社	日本セミラボ株式会社	株式会社レゾナック
／次世代半導体基板のための実用加工技術検討会	ノリタケ株式会社	Huai'an Litai Silicon Carbide Micro Powder Co., Ltd
JFEテクノリサーチ株式会社	株式会社バイコウスキージャパン	(五十音順)
株式会社ジェイテクトマシンシステム	浜井産業株式会社	
／株式会社ジェイテクトグラインディングツール	バルステック工業株式会社	

出展対象

- SiC,GaN用インゴットスライシング装置 ● SiC,GaN用ウエハ研削装置 ● SiC,GaN用研削砥石 ● ウエハ端面研削・研磨装置
- SiC,GaN用片面・両面ラッピング装置 ● SiC,GaN用CMP装置 ● SiC,GaNウエハ専用研磨材スラリー
- ウエハ洗浄システム ● ウエハ形状測定機



**現場の答えが見つかる
研削加工の専門展示会**

www.gtj-expo.jp



2展示会 同時開催

SiC, GaN 加工技術展 2025

**先進パワー半導体
ウエハ加工技術に
関する専門展示会**

www.sicgan-expo.jp

主催 / 日本工業出版 産経新聞社

2025.3.5(水)～3.7(金) 幕張メッセ

開催概要

会期	2025年3月5日(水)～7日(金) 3日間	開場時間	10:00～17:00
会場	幕張メッセ 展示ホール8 (〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1)		
入場料	無料(事前登録制)	主催	日本工業出版 産経新聞社

名称 Grinding Technology Japan 2025

企画 日本工業出版(株)「機械と工具」編集部

後援 在日ドイツ連邦共和国大使館

特別協賛 切削フォーラム21

特別協力 (公社) 砥粒加工学会

ネットワークパートナー Grind Tec

協賛 日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機工業会、日本フルードパワー工業会、日本試験機工業会、日本歯車工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、ターボ機械協会、日本機械鋸・刃物工業会、全国機械用刃物研磨工業協同組合、日本包丁研ぎ協会、バリ取り・表面仕上げ・洗浄協会

名称 SiC,GaN加工技術展 2025

特別協力 (公社) 砥粒加工学会
(公社) 応用物理学会 先進パワー半導体分科会

協賛 日本工作機械工業会、日本工作機械輸入協会、日本工作機械販売協会、日本鍛圧機械工業会、日本精密機械工業会、日本機械工具工業会、日本工作機器工業会、日本精密測定機器工業会、研削砥石工業会、ダイヤモンド工業協会、日本光学測定機器工業会、日本フルードパワー工業会、日本歯車工業会、日本機械鋸・刃物工業会、精密工学会、日本フルードパワーシステム学会、ターボ機械協会、SiC アライアンス、GaNコンソーシアム

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、大量の先進パワー半導体が必要になってきました。しかし、これら半導体材料は非常に硬く、高い加工コストが問題となっています。本加工技術展は、それらの課題を持って来場される皆様に、最新の技術・知識で最良の回答を用意しています。

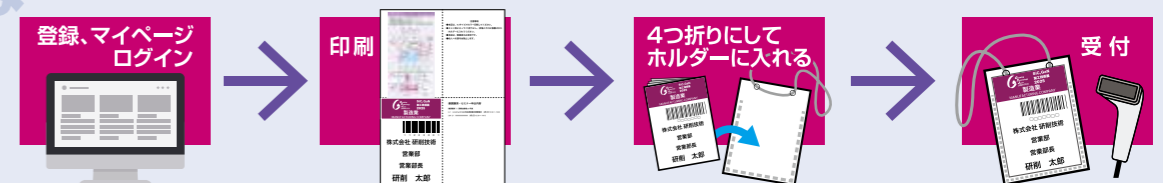


スーパーバイザー 河田研治

来場するには

来場事前登録

受付期限：会期終了まで



登録フォームから必要事項を入力後、配信されるメールのURLからID、パスワードでマイページにログインしていただき、「入場受付証」をプリントアウトして当日会場にご持参ください。会場にて専用ホルダーに入れ、バーコードチェックを受けてください。

お問い合わせ

Grinding Technology Japan 2025 / SiC,GaN 加工技術展 2025 展示会事務局(株式会社ティ・シー・エス)
〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-32 芝大門ビル
TEL : 03-3432-4722 FAX : 03-3432-4730 E-mail : gtj@t-c-s.co.jp / sicgan@sankei.co.jp

※本案内状に記載の事項はやむを得ぬ事情により変更になる場合がございます。最新情報は必ずWebサイトにてご確認の上、ご来場ください。(2024年12月5日現在)

GTJパネルディスカッション 国際会議場201号室

10:30～12:00 『これからの工具づくりと工具研削盤を考える～DX化、自動化への対応』

司会: 日本工業大学 工業技術博物館・館長、上智大学 名誉教授、MAMTEC・代表 清水 伸二氏

パネラー: 株式会社MOLDINO 野洲工場 生産技術部長 佐藤 亮介氏、フォルマー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 カール・モーサ氏、牧野フライス精機株式会社 常務取締役 技術部ゼネラルマネージャ 安西 貞司氏、ユナイテッドグライディング株式会社 工具研削アプリケーショングループ テクニカルマネージャー 大倉 透氏

GTJ技術セミナー「研削加工」 国際会議場201号室

13:00～13:45 センシングを駆使した加工結果の予測と可視化技術 株式会社ナガセインテグレックス 常務取締役 製造本部 副本部長 技術統括 板津 武志氏

14:00～14:45 機上研削焼け評価システムによる焼け深さ推定技術 株式会社ジェイテクト データアナリティクス研究部 解析技術研究室 後藤 直規氏

15:00～15:45 フルト研削用ホイールの近年の動向 旭ダイヤモンド工業株式会社 玉川工場 技術本部 応用技術部 上久木田 直樹氏

GTJ技術セミナー「切削工具」 国際会議場201号室

13:00～13:45 自動化、情報化時代の工具と切削技術の進め方 株式会社松岡技術研究所 代表取締役 松岡 甫寛氏

14:00～14:45 デジタルトランスフォーメーション(DX)により工具はどのように変わるのか サンドビック株式会社 コロマントカンパニー 執行役員 機械搭載推進部 部長 河野 史尚氏

15:00～15:45 高付加価値切削工具製造に求められる工具研削盤の最新技術 株式会社コーショー 大阪営業所 営業部 所長代理 中村 文治氏

GTJ基調講演 国際会議場201号室

10:30～11:15 日本の工作機械メーカーが取るべきニッチトップ戦略と産学連携のあり方 日本工作機械メーカーは、その強みが所謂「中小企業」だが、各社は特定分野で優れた製品・技術を保有し、顧客企業にとって、またその加工プロセスに必要な不可欠な存在として長年に亘り存続してきた。しかしながら、近年は新興メーカーの追い上げや市場のグローバル化などの競争の激化、AIなどに代表されるソフト領域での新技術の登場、さらには要求精度の超高度化など、中小工作機械メーカーを取り巻く環境は厳しさを増してきている。本講演では、そのような時代を勝ち抜く手段としてのニッチトップ戦略を、産学連携のあり方を交えながら提案したい。 公益社団法人砥粒加工学会 会長、牧野フライス精機株式会社 取締役社長 清水 大介氏

GTJ技術セミナー「FGS(フレキシブル・グライディング・システム)が拓く新たな研削の世界」 展示会場内特設会場

14:00～14:45 工作機械スピンドルの研削加工自動化システム シチズンマシナリー株式会社 生産本部生産技術部 副本部長 小林 勝義氏

15:00～15:45 研削仕様による自動化の取り組み 株式会社牧野フライス製作所 カスタムアプリケーションセンター マテリアルエンジニアリング部 エアロスペースグループ 本多 寿矢氏

16:00～16:45 工具研削盤と工具測定器の連携による、現実的な工具自動生産システム(ATP)の紹介 ユナイテッドグライディング株式会社 工具研削アプリケーショングループ テクニカルマネージャー 大倉 透氏

砥粒加工学会 ATF2025講演会 有料

10:30～15:50 『ものづくりの30年の変遷と30年後の未来』

主催 公益社団法人 砥粒加工学会 ▶ 申込方法: ATF2025講演会の お申し込みはこちら▶▶▶

3月6日(木) 展示会場内特設会場

10:30 時代により変化するニーズへ対応した超精密加工研究の変遷 一鏡面仕上げから高機能表面創成への道 理学化学研究所 主任研究員 大森 整氏

11:20 ものづくりに貢献する研削盤・研削加工の変遷 (30年の振り返りと、これからの語る) 元(公社)砥粒加工学会会長 元(株)ジェイテクト 向井 良平氏

13:10 中小企業の未来を拓くAI活用 元 産業技術総合研究 研デジタルものづくりセンター 所長 森 和男氏

14:00 パフ研磨技術のDXと今後 合同会社KAGAMI 代表社員 松澤 正明氏

15:00 未来の産業-宇宙産業におけるものづくり 一太陽系宇宙の開発、はやぶさを越えて、新型ロケット発進! 大阪産業大学 副学長 田原 弘一氏

16:10 総会

製品・技術発表会 無料

事前申込制 (定員になり次第締め切ります。) ▶ 申込方法: ホームページよりお申し込みください。 www.gtj-expo.jp

3月5日(水)

11:30 クール・テック株式会社 アルカリイオン水でクーラント液腐敗防止・ドレス間研削加工数UP事例のご紹介

12:15 株式会社トクビ製作所 超高压クーラントの研削砥石改善効果

13:30 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 切削加工時の切屑や刃先温度を評価するシミュレーション技術

14:15 株式会社岡本工作機械製作所 超精密・鏡面加工、機上計測、自動化、脆性材加工を製品開発のテーマに掲げた「研削革命」による研削技術の紹介

14:30 株式会社岡本工作機械製作所 大径深穴内面研削スピンドル開発技術の体系的紹介

15:15 株式会社岡本工作機械製作所 防衛大における研削・研削加工技術高度化の取り組み

15:30 株式会社岡本工作機械製作所 ～SiCインゴット研削からウエハ最終仕上げポリッシュまで～生産性向上の提案

16:15 ～SiCインゴット研削からウエハ最終仕上げポリッシュまで～生産性向上の提案

3月7日(金)

10:30 レッテンマイヤー・ジャパン株式会社 セルロース過剰剤でコスト削減!～ろ過時間延長、低廃棄物、オイルロス低減～

11:15 株式会社岡本工作機械製作所 ～SiCインゴット研削からウエハ最終仕上げポリッシュまで～生産性向上の提案

11:30 株式会社岡本工作機械製作所 ～SiCインゴット研削からウエハ最終仕上げポリッシュまで～生産性向上の提案

12:15 エリコンジャパン株式会社 「歯切り加工の課題をコーティングで解決」

SiC, GaNパネルディスカッション 国際会議場201号室

10:30～12:00 パワー半導体用大口径SiCウエハの加工技術-8インチ量産プロセスのゆくえ-

司会: 国立研究開発法人産業技術総合研究所 エネルギー・環境領域 先進パワーエレクトロニクス研究センター ウェハプロセスチーム チーム長 加藤 智久氏

パネラー: 株式会社レゾナック デバイスソリューション事業部 SiC技術開発部 GIプロジェクト 加工テーマ サプライダー 伊藤 正人氏、ノイエテクノラボ 代表 阿部 耕三氏、株式会社東京精密 半導体技術部門 加工・バックエンド技術部 アプリケーションセンター HRGチームリーダー 兼 プロダクトセールスチーム 主査 五十嵐 健二氏、株式会社フジインコーポレーテッド シリコン開発部 半導体新規事業課 課長 高見 信一郎氏

公益社団法人 応用物理学会 先進パワー半導体分科会 第28回研究会 国際会議場201号室

「SiC, GaNパワーデバイスの現状ならびに新しい基板加工技術」

12:30～12:35 開会挨拶

12:35～13:05 SiCパワー半導体の現状と今後の展開 産業技術総合研究所 先進パワーエレクトロニクス研究センター 研究センター長 田中 保宣氏

13:05～13:35 GaN縦型パワーデバイスの現状と今後の展開 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 須田 淳氏

13:45～14:15 SiCウエハの高速研磨装置の開発 不二越機械工業株式会社 開発研究部 開発研究課 課長 宮下 忠一氏

14:15～14:45 SiCのワイヤソー切断技術と新しい平坦化技術 株式会社安永 事業本部 CE部門 OP部 次長 乾 義孝氏

14:55～15:25 触媒表面基準エッチング法によるSiCおよびGaN基板表面の原子レベル平坦化 大阪大学 大学院工学研究科 助教 藤 大雷氏

15:25～15:55 固体電解質を用いた環境調和型電解援用研磨によるSiCの高効率平滑化 立命館大学 理工学部 教授 村田 順二氏

15:55～16:00 閉会挨拶

■参加受付: WEB 参加受付システム (QRコード) から参加登録と参加費のオンライン決済をお願いします。席数に限りがあるため早期に参加受付を終了することがあります。なお、当日の資料はPDF版となります。

■参加費: (消費税込) 先進パワー半導体分科会会員* 4,000円 分科会学生会員 無料 一般 6,000円 一般学生 1,000円 *先進パワー半導体分科会賛助会員の方には先進パワー半導体分科会会員扱いとします。

■現地開催におけるご協力のお願い: 発熱がある場合は当日のご参加はご遠慮下さい。会場でのマスクの着用は任意とします。

※適宜休憩が入ります。

砥粒加工学会 展示コーナー 展示会場内特設会場

砥粒加工学会は1957年に砥粒加工研究会と関西砥粒加工研究会を母体として発足し、1995年に法人化、2009年には公益社団法人に認定されました。この間、一貫して砥粒加工技術、工具技術、加工機械、計測技術など、実践的なものづくり技術を総合的にとらえる学会として、参加して「役に立つ学会」、「楽しい学会」として発展してきました。 今年の見本市では最新の研削加工技術や研削工具の計測・評価技術、レーザ加工技術、超精密・微細加工技術、環境調和型加工技術等、幅広い分野の研究展示が行われます。是非、ご来場ください。

参加校

中部大学 超精密加工(鈴木)研究室 光学部品超精密加工	埼玉工業大学 マイクロ・ナノ工学研究室(長谷川研究室) 砥粒加工分野に寄与するAEセンシングとトライボロジー
日本工業大学 精密加工研究室 超音波応用技術 他	日本工業大学 機械加工(二ノ宮)研究室 レアメタル含有肉盛ドレッサによるダイヤモンド砥石の刃先高さ調整
埼玉大学 生産環境科学研究室 SiCの切断・研磨	富山県立大学 岩井研究室 環境調和型高効率・高精度加工技術
群馬大学 先端加工技術研究室 先端加工技術とその加工現象解析	芝浦工業大学 先進製造プロセス研究センター・臨床機械加工研究室 研究内容の紹介
茨城大学 n Lab(清水・小貫・尾崎研究室) 次世代半導体研削と計測評価	中部大学 先端マイクロ加工工学研究室 機上工具磨削画像に基づく工具状態推定法の開発
秋田県立大学 先端加工技術研究室 ものづくりを加速させる高性能加工ツールの開発	若手大学 水加工環境調和型システムネットワーク 環境と人にやさしい水加工システム(電気防錆加工システム)などについて
中部大学 安達研究室 大径深穴内面研削スピンドル開発技術の体系的紹介	神奈川大学 中尾研究室 スピンドルの熱的特性
足利大学 精密加工研究室 砥石研削盤にわたる精密研削技術の開発研究	大阪大学 山村研究室 プラズマおよび電気化学を用いたナノ製造プロセス
防衛大学校 精密加工研究室・制御加工研究室 防衛大における研削・研削加工技術高度化の取り組み	千葉工業大学 松井研究室 環境材料の研削技術
金沢工業大学 諏訪部研究室 レーザによって砥粒を固着したダイヤモンド工具の開発	東京都市大学 表面加工研究室 研削加工・レーザ加工・研削加工を軸とした機能性表面創製の研究
東京電機大学 ナノ精度加工研究室 ナノ精度加工に関する研究紹介	岡山大学 機械加工工学研究室 切削・研削・砥粒加工の高度化・最適化技術の開発
佐世保工業高等専門学校 研削加工AI評価研究室 深層学習を用いた砥石作業量の変化形態の評価・解析	日本大学 山田・内田研究室 砥石表面形状に基づく研削現象の評価
東北大学 水谷・久慈研究室 「鋭い刃を」を「鋭く変える」モルフォロジーの制御による研削加工の最適化	立命館大学 機能性表面創成工学研究室 固相電気化学プロセスが拓く環境調和型機能性表面創成
関西大学 生産加工システム研究室 研究紹介(超精密研削、マイクロメカニクス) 超精密研削、微細加工の高精度化、微細加工の高精度化	大阪大学 佐野研究室 砥粒と水のみを利用した極めて環境調和型・低公害な表面加工技術
千葉大学 加工物理学研究室 薄板ガラスの制御における電場誘起変形と制御形成メカニクスに関する研究	

研削コンシェルジュ 無料

事前申込制 (定員になり次第締め切ります。) 5名の専門家が常駐します。特定のメーカーには相談しにくい案件、メーカーではなくアカデミックな方への理論的な疑問など、研削に関するあらゆるお悩みに対応いたします。 事前予約制となります。ホームページからご希望の日時を選択、お申し込みください。 ▶ 申込方法: ホームページよりお申し込みください。 www.gtj-expo.jp

岡山大学 学術研究院 環境生命自然科学学域 教授/(公社)精密工学会 副会長 大橋 一仁氏 専門: 研削加工 得意分野: 研削プロセスの計測技術、難削材の研削加工、研削砥石 事前予約可能枠 5日(水)～7日(金) ① 10:30～11:15 ② 11:30～12:15

神奈川県 技術アドバイザー 愛恭輔氏 専門: 研削加工 得意分野: 超砥粒ホイール活用技術、難加工材の研削加工技術、高効率研削技術 事前予約可能枠 5日(水)～7日(金) ① 13:30～14:15 ② 14:30～15:15

ものづくり大学 名誉教授 東江 真一氏 専門: 研削加工、機械加工 得意分野: 研削技術教育、超砥粒砥石ドレッシング、カスタムマクロプログラミング 事前予約可能枠 5日(水)～7日(金) ① 10:30～11:15 ② 11:30～12:15

芝浦工業大学大学院 機械工学専攻 臨床機械加工研究室 教授 澤 武一氏 専門: 研削加工、切削加工、IoT・DX、技能継承 得意分野: 多くの企業と生産現場に直結した臨床研究に取り組んでいます 事前予約可能枠 5日(水)～7日(金) ① 13:30～14:15 ② 14:30～15:15

元黒田精工株式会社 山下 富雄氏 専門: 研削加工技術と設計技術 得意分野: 精密研削加工、精密機器組立、精密機械設計 当日受付 5日(水)～7日(金) ① 10:30～11:15 ② 11:30～12:15